

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年9月28日(28.09.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/182138 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 183/05 (2006.01)
C08L 83/05 (2006.01) C09J 183/07 (2006.01)
C08L 83/07 (2006.01) H01L 21/02 (2006.01)
C08L 83/12 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/010292

(22) 国際出願日: 2023年3月16日(16.03.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-048118 2022年3月24日(24.03.2022) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 柳井 昌樹(YANAI Masaki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 奥野 貴久(OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也(SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡 IP特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: ADHESIVE CONTAINING POLYETHER-MODIFIED SILOXANE

(54) 発明の名称: ポリエーテル変性シロキサンを含有する接着剤

(57) Abstract: The present invention provides an adhesive and a laminated body having the adhesive. The adhesive exhibits excellent performance in spin coating onto a wafer circuit surface or a support body (support substrate), is excellent in heat resistance in joining a wafer circuit surface and a support body via the adhesive layer and in processing a wafer back surface, and facilitates peeling of the wafer from the support body after processing the wafer (after polishing the wafer back surface, for example). The adhesive adheres a support body and a wafer circuit surface in a peelable manner and is for processing the back surface of the wafer. The adhesive includes: a component (A) curing through hydrosilylation reaction; and a component (B) including a polyether-modified siloxane.

(57) 要約: ウエハーの回路面や支持体(支持基板)へのスピンコート性に優れ、接着層を介してウエハーの回路面と支持体とを接合する接合時やウエハー裏面の加工時における耐熱性に優れ、ウエハー加工後(例えば、ウエハー裏面の研磨後)にはウエハーと支持体とを容易に剥離できる接着剤、該接着剤を有する積層体の提供。支持体とウエハーの回路面との間で剥離可能に接着し、ウエハーの裏面を加工するための接着剤であって、前記接着剤は、ヒドロシリル化反応により硬化する成分(A)と、ポリエーテル変性シロキサンを含む成分(B)とを含む、接着剤である。

WO 2023/182138 A1